

证券代码：688728

证券简称：格科微

格科微有限公司
投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	参与公司 2025 年半年度业绩说明会的全体线上投资者
时间	2025 年 10 月 20 日
地点	上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/ ）
上市公司接待人员姓名	董事长 赵立新 董事会秘书兼财务总监 郭修贇 独立董事 周易
投资者关系活动主要内容介绍	1、请问贵公司在盈利能力方面有什么具体措施？新产品推出及其销售有哪些具体安排？ 近几年来，公司持续开发、深化公司独创的高像素单芯片集成技术以及相关产品，目前已取得了长足的进步。2025 年上半年，公司 1,300 万及以上像素产品的收入超过 10 亿元，占手机 CIS 产品业务约 46%，3,200 万及以上像素产品出货量已超过 4,000 万颗，高像素产品收入比重进一步提升，标志着公司创新的单芯片高像素芯片集成技术得到市场的进一步认可。后续公司将进一步迭代高像素产品性能，持续开发更高像素，如 1 亿及以上像素产品，不断增强公司的核心竞争力，提升市场份额、扩大领先优势。 此外，在非手机 CMOS 图像传感器领域，公司持续丰富产品规格，迭代升级产品矩阵，拓展产品应用领域，并持续完善内外协同的产能结构，与更多国内代工厂商达成良好的合作关系。公司积极布局车载前装芯片，首颗 3.0 μm130 万像素产品已在客户端调试，主要用于 360° 环视，倒车后视等市场；另外公司积极研发在自有工厂生产，并支持公司自主研发 A-COM 封装的 3.0 μm300 万像素产品，可应用于环视、周视、自动泊车、前视一体机等应用。另外，公司持续关注 AI 眼镜等相关新兴市场发展，并积极推进相关技术研发进展与

	产品落地，已有 500 万像素 CIS 在 AI 眼镜项目量产。公司还结合独创的光学防抖封装，产品切入微单、卡片机、望远镜等细分领域，进一步拓展市场空间。未来，公司将持续以 CIS 为核心，搭配 COM 系列等高性能 CIS 封装方案，为设备装上更轻薄、更智能的“眼睛”。 显示驱动芯片业务方面，2025 上半年，公司 LCDTDDI 产品销售占比持续提升，同时实现了首颗 AMOLED 显示驱动芯片产品在智能手表客户的成功交付，这标志着公司完成 OLED 显示技术与算法的关键积累，成功迈入快速增长的 OLED 显示市场，拓宽了显示驱动业务增长空间。 2、请介绍公司战略定位、单芯片产品推广进度、产线利用情况等 公司自设立以来，始终专注于 CMOS 图像传感器芯片和显示驱动芯片领域，致力于为客户提供一流的拍照、视频及显示技术整体解决方案。公司凭借在芯片设计和工艺研发方面的先进技术，在保证产品性能的同时大幅降低了产品成本，形成了极具市场竞争力的产品线，历经近二十年的发展后在全球市场范围内取得了显著的规模优势和领先的行业地位。 但是，面对激烈的市场竞争，面对占据绝大部分市场份额的海外 CIS 巨头，近年来，公司持续思考和探索国产 CIS 企业立足国际竞争的新技术、新经营模式。公司提出了在产品定位方面实现从高性价比产品向高性能产品的拓展，在产品应用方面实现从副摄向主摄的拓展，在经营模式方面实现从 Fabless 向 Fab-Lite 的转变的战略方向。 一方面，公司持续深化单芯片高像素技术及产品的开发。2025 上半年，公司创新升级的 GalaxyCell®2.0 工艺，针对多种拍摄环境特别是暗光场景，具有显著的性能提升，同像素规格产品表现更加出色。公司基于最新 GalaxyCell®2.0 工艺平台，持续推进中高像素 CIS 产品的研发与迭代，目前已形成覆盖 0.61 μm、0.7 μm、0.8 μm、1.0 μm 等各系像素规格的全系列产品。2025 年上半年，公司 1,300 万及以上像素产品的收入超过 10 亿元，占手机 CIS 产品业务约 46%，3,200 万及以上像素产品出货量已超过 4,000 万颗，多个规格的单芯片 3200 万、5000 万像素产品已经在 OPPO、vivo、传音等主流安卓品牌客户的海量机型导入并量产（部分产品具体上机情况可通过公司公众号“格科 GalaxyCore”了解），高像素产品收入比重进一步提升标志着公司创新的单芯片高像素芯片集成技术得到市场的进一步认可。后续公司将
--	--

	进一步迭代高像素产品性能，不断增强公司的核心竞争力，提升市场份额、扩大领先优势。 另一方面，公司认为，未来，CMOS 图像传感器像素的提升将成为行业主流企业竞争的主要切入点，拥有自主产线的企业将在产能保障更为有效的同时，进行高效的内部协同与研发，从而推动新产品及新工艺的快速推出，是占据行业前沿地位、提升市场份额的有力手段。IDM、Fab-lite 将成为半导体企业发展的一大趋势。因此，公司近年来自建晶圆厂并快速实现良性的正向运转，这并非为了追求短期的成本优势，而是为了实现工艺与设计的更高效协同，加快创新迭代。 2025 年上半年，格科半导体工厂基本处于满产状态，产能持续由 800 万、1,300 万像素产品向 3,200 万及 5,000 万像素产品切换，格科半导体产品单位价值量持续提升，助力提高工厂自身盈利能力，加快工厂实现盈亏平衡进度。此外，格科半导体工厂还可实现产品定制，满足如旗舰手机、车载、PC 等领域品牌客户对产品的独特需求，进一步加强了公司竞争壁垒。格科微浙江持续专注于 CIS、DDIC 封测制造与相关技术研发，目前设立 FT、CP、RW、COM 等产品线和 OIS 研发项目，并积极进行 IATF16949 车规认证，致力于提高公司一体化竞争能力。未来，自有工厂将进一步加强公司在芯片设计端和制造端的资源整合，提升设计和工艺水平，加快研发成果产业化的速度，不断增强公司的核心竞争力，为公司提高市场份额、扩大领先优势奠定发展基础。 整体而言，公司目前形成了区别于竞争对手的创新型技术路径，不存在显著的技术专利壁垒和潜在障碍，并通过多年来中低阶 CIS 产品积累的良好品牌客户基础，快速实现了高阶 CIS 产品的商业化落地。同时，通过向 Fab-Lite 模式的转变，公司能够有效提升高阶 CMOS 图像传感器的研发效率及产能保障力度，进一步确保了高阶产品研发推广的可行性。公司将不断巩固和提升在 CMOS 图像传感器领域的竞争力和影响力，持续为股东、员工、客户以及所处产业链创造价值，成为行业领先、受人尊敬的 CMOS 图像传感器产品及方案供应商。 3、在智能驾驶领域公司都有哪些产品，都与哪些头部公司有合作？ 公司积极布局车载前装芯片，首颗 3.0 μm130 万像素产品已在客户端调试，主要用于 360° 环视，倒车后视等市场；另外公司积极研发在自有工厂生产，
--	--

	并支持公司自主研发 A-COM 封装的 3.0 μm300 万像素产品，可应用于环视、周视、自动泊车、前视一体机等应用。 4、公司 CMOS 图像传感器技术在国内地位如何？ 公司为国内领先、国际知名的半导体和集成电路设计企业之一，主营业务为 CMOS 图像传感器和显示驱动芯片的研发、设计、制造、封测和销售。公司在 CMOS 图像传感器领域和显示驱动领域深耕多年，拥有业内领先的工艺研发和电路设计实力。凭借优异的产品质量与性价比、高效的服务与技术支持、强大的供应链垂直整合能力，公司累积了深厚的客户资源，并在市场上占据了独一无二的地位。目前，公司已成为国内领先、国际知名的 CMOS 图像传感器和显示驱动芯片供应商。
附件清单（如有）	无
关于投资者调研活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次业绩说明会不涉及应当披露的重大信息。